

Title (en)

System for interconnection between electronic boards

Title (de)

VERBINDUNGSSYSTEM ZWISCHEN ELEKTRONISCHEN KARTEN

Title (fr)

Système d'interconnexion entre des cartes électroniques

Publication

EP 2445060 A1 20120425 (FR)

Application

EP 11185387 A 20111017

Priority

FR 1058535 A 20101019

Abstract (en)

The system (1) has a first coupling sub-assembly (4) and a second coupling sub-assembly (5) comprising a set of housings for receiving one of connectors. The first and second sub-assemblies are fixed on a first electronic board (2) and a second electronic board (3), respectively. A third coupling sub-assembly (6) comprises another set of housings for receiving connector connections, where the connections connect connectors (7, 8) of the first sub-assembly with the connectors of the second sub-assembly. The third sub-assembly is arranged between the first and second coupling sub-assemblies. An independent claim is also included for a method for interconnecting two electronic boards.

Abstract (fr)

La présente invention concerne un système (1) d'interconnexion entre deux cartes électroniques (2,3), caractérisé par le fait qu'il comporte : - un premier (4) et un deuxième (5) sous-ensemble comportant des logements recevant chacun au moins un connecteur, le premier (4), respectivement deuxième (5), sous-ensemble étant configuré pour être fixé sur une première (2), respectivement deuxième (3), carte électronique, et - un troisième sous-ensemble de couplage (6), comportant des logements recevant des raccords de connecteurs, lesdits raccords de connecteurs étant configurés pour raccorder les connecteurs du premier sous-ensemble (5) avec les connecteurs du deuxième sous-ensemble (6), le troisième sous-ensemble (6) étant configuré pour être disposé entre les premier (4) et deuxième (5) sous-ensembles.

IPC 8 full level

H01R 12/51 (2011.01); **H01R 12/52** (2011.01); **H01R 12/71** (2011.01); **H01R 12/91** (2011.01); **H01R 13/631** (2006.01); **H01R 43/26** (2006.01); **H01R 9/24** (2006.01); **H01R 13/506** (2006.01)

CPC (source: EP US)

H01R 12/52 (2013.01 - EP US); **H01R 12/91** (2013.01 - EP US); **H01R 13/506** (2013.01 - EP US); **H01R 13/514** (2013.01 - EP US)

Citation (applicant)

US 6231352 B1 20010515 - GONZALES OLIVIER [FR]

Citation (search report)

- [Y] US 2008242161 A1 20081002 - TAKADA TOSHIYUKI [JP], et al
- [Y] US 5516303 A 19960514 - YOHN BRENT D [US], et al
- [Y] US 2004229490 A1 20041118 - BERNAT JEAN FRANCOIS [FR], et al
- [Y] US 2004072472 A1 20040415 - BARRY JOHN BRETT [US], et al
- [Y] US 2009186495 A1 20090723 - TAYLOR PAUL R [US]
- [A] US 2008220630 A1 20080911 - SIPE LYNN ROBERT [US], et al

Cited by

EP3588685A1; EP3389145A1; EP3389144A1; US10446955B2; EP3399597A3; US10505303B2; US10665976B2; US11056807B2; US11901654B2

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

EP 2445060 A1 20120425; CN 102544794 A 20120704; FR 2966289 A1 20120420; JP 2012089498 A 20120510; US 2012094526 A1 20120419; US 8360789 B2 20130129

DOCDB simple family (application)

EP 11185387 A 20111017; CN 201110318033 A 20111019; FR 1058535 A 20101019; JP 2011229891 A 20111019; US 201113274866 A 20111017